

南京高华科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：202407

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（特定对象网上路演活动）
参与单位名称及人员姓名	详见附件：参与调研机构名单
时间	2024年7月24日 2024年7月25日
地点	南京经济技术开发区栖霞大道66号高华科技5楼505会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 陈新 证券事务专员 周睿
投资者关系活动主要内容介绍	<p>交流的主要问题及答复内容：</p> <p>介绍了公司的基本情况、经营情况、2024年经营计划及未来发展战略。</p> <p>1、近期关注到公司与抒微智能签订了合作协议，公司为什么参投这家企业呢？业务上有什么协同吗？</p> <p>答：南京抒微智能科技有限公司是一家致力于高性价比激光传感器技术开发及其应用解决方案产业化的科技型企业。该公司围绕“Lidar+算法”的产品思想，通过激光传感器为行业提供专业解决方案及智能模块。基于深度契合的发展规划、互补共赢的产业优势和高度信赖的合作意向，双方一致同意在股权投资的同时落实产业合作，以高华科技丰富的产业化经验和抒微智能专业的技术工艺积淀，优化制造流程，改进生产工艺，</p>

共建激光传感器产品生产线。双方的产业合作，将有助于高华科技迅速提高激光传感器研发能力和制造技术水平，丰富智能传感器产品品类，增强为客户提供更全套解决方案的能力和核心竞争力，进一步巩固高华科技传感器行业领军企业地位；同时高华科技在高可靠性传感器方面先进的制造能力、广泛的客户基础、良好的品牌效应、充足的资金实力，将有助于充分发挥抒微智能的技术优势。后续，双方将携手推进激光雷达技术开发及其应用解决方案的产业化，有效拓宽产品应用场景，深入布局智能制造、低空经济、智能机器人、智能交通等领域所需智能传感器产品，进一步提升双方经营效益，呈现良好的协同效应，实现互利共赢的合作目标。目前公司与抒微智能的合作尚处于初始阶段，对公司营收和利润的不构成重大影响，敬请广大投资者注意。

2、公司募投项目二期建设的规划？目前进展如何？

答：高华生产检测中心项目将利用高华传感自有土地新建生产检测中心及配套设施并进行装修改造，将面向军用及工业领域分别扩建或新建压力传感器、加速度传感器、温湿度传感器等不同传感器的多条生产线及建设检验部门，购置性能先进的温度-湿度-高度三综合设备、自动贴盖机、全自动化芯片粘贴机等生产类设备以及质检类设备，扩充员工团队规模，从而大幅提升公司生产能力，面向军用领域和工业领域实现高可靠性传感器等主导产品的规模化扩产。通过上述项目实施，公司将新增面向军用领域和工业领域的年产 53 万支高可靠性传感器成品的生产能力。目前公司募投项目正在推进实施中，募投项目高华生产检测中心主体建筑即将封顶，募投项目相关实施进展情况请关注公司披露的募集资金存放与实际使用情况专项报告。

3、公司民品市场的发展及 2024 年的拓展计划是什么样的？

答：2023 年公司工业品市场拓展保持稳定增长态势。在轨道交通领域，伴随着铁路出行需求的显著提升以及高速动车组智能化水平的进一步发展，公司产品配套需求显著增长；公司深度参与高铁动车组牵引、制动等关键系统的传感器国产化项目，为后续扩大市场规模打下了坚实基础；在机械装备领域，面对日益紧张的国际能源形势，国内能源需求持续增长，针对智慧矿山和装备智能化带来的蓬勃需求，公司加大与行业龙头企业的合作，不断丰富配套传感器的品种，提升装备智能化水平，为进一步提高市场占有率打下基础；在冶金领域，公司加强与宝武集团、建龙集团等龙头企业的合作，不断扩充设备健康监测相关产品品类，优化软件算法，提供完善的设备远程智能运维解决方案。公司将继续加强与现有客户合作，提供定制化的解决方案，增加客户粘性，同时，也将积极布局商业航天、低空经济等领域，开发符合市场需求的传感器产品，提高市场份额。

4、公司在低空经济领域的布局是怎样的？

答：航空制造业是低空经济的基石，eVTOL、直升机、小型飞机和无人机是低空经济的重要载体，而压力传感器、温度传感器、IMU 等传感器是 eVTOL 等飞行器的必备器件，用以对飞行器的状态检测与导航控制等。公司是高可靠性传感器及传感网络系统核心供应商，已具备 MEMS 传感芯片、ASIC 调理电路的自主设计能力，在传感器设计、封装测试、传感器网络系统方面，掌握多项核心技术，且持续多年深耕于航空领域，有丰富的航空装备配套经验，具备良好的技术研发能力与客户服务响应能力。2024 年 1 月，公司以自有资金投资南京邦盛赢新二号创业投资合伙企业（有限合伙），充分利用其在高科技投资领域的丰富经验，积极切入低

空经济、新能源、新材料等新兴产业，实现公司产业链整合及效益回报。目前，参股邦盛赢新对公司业绩的影响较小。

5、公司如何展望商业航天的发展前景？在商业航天领域的优势是什么？

答：根据中国航天科技集团有限公司发布的《中国航天科技活动蓝皮书（2023年）》，2023年中国航天实施了67次发射任务，2024年中国航天全年预计实施约100次发射任务。随着国家出台一系列利好政策，我国商业航天产业也迎来了全新发展机遇。高华科技一直以来面向航天、航空等高端应用领域，专业从事高可靠性传感器及传感网络系统的研发、设计、生产及销售。公司已与中科宇航、星河动力、零壹空间、星际荣耀、东方空间等商业航天伙伴建立合作关系。公司为商业火箭研制高质量、高可靠性的传感器、变换器等产品，主要应用于全箭遥测及控制系统、火箭发动机、试车台、发射靶场等场景。品种包括压力、温度、三轴及单轴振动、冲击、位移等传感器，以及数据采集系统，实现了从单点测试到系统集成监测全范围覆盖，帮助精密测量火箭飞行过程中的各类参数，实现对火箭的跟踪、遥测及控制。公司不断进行技术迭代和产品优化，丰富产品种类，提供有线传感与无线传感组合等多层次的解决方案。同时，公司积极打造高效的供应体系，加速推进二期建设，加强成本管控，从产品模块化设计、数字化智能制造、产业协同等多维度发力提高供应保障能力，并不断完善售后服务及外场使用保障体系。

6、公司产品品类拓展计划是怎样的？

答：从市场空间看，如今传感器市场增速较快，压力、加速度、温湿度等细分市场增长态势良好，同时航天、航空、兵器、轨

	<p>道交通、工程机械、冶金等不同下游应用领域的市场空间日益增长。在上述应用领域的良好发展趋势下，公司产品将迎来更广阔的应用。</p> <p>2023 年度，公司稳步推进传感器芯片、传感器、传感网络系统等研发工作及技术成果转化，完成扩散硅及 SOI 工艺 MEMS 压力传感器芯片、磁致伸缩位移传感器、测高传感器、转速传感器、浓度传感器、箭用噪声传感器、发射塔架活动平台健康监测系统等产品的研发，进一步提升了公司核心竞争力及对多场景的应用能力。根据募投项目“高华研发能力建设项目”的规划，公司计划针对四大技术方向开展研发攻关，分别为 MEMS 传感芯片技术研发、传感器新产品研发、传感网络系统平台技术研发和智能设备运维管理系统研发。此外，公司持续开拓不同应用领域的龙头客户，并且针对不同领域的应用场景，依靠自身优秀的设计能力、生产工艺、过程控制能力以及应用案例与经验的深厚积累，形成不同领域的定制化产品并保持高可靠性，不断丰富公司产品品类，满足不同客户的需求。未来公司将积极发挥自身优势，不断拓展商业航天、新能源、低空经济等新兴产业的市场空间，并开展深度合作。</p>
附件清单（如有）	见附件参与调研机构名单

附件：参与调研机构名单

1	东北证券股份有限公司
2	杭州附加值投资管理有限公司
3	中邮保险资产管理有限公司
4	西南证券股份有限公司
5	中信建投基金管理有限公司
6	国泰君安证券股份有限公司